



Leiterplattenbearbeitung

Leiterplattenbearbeitung

Mit innovativer Lasertechnik bieten wir das **Konturschneiden** von Leiterplatten, die Herstellung von **Microvia**-Bohrungen in HDI-Leiterplatten und das Laserstrukturieren der Leiterplatten-Oberflächen an. Unsere Ultrakurzpuls(UKP)-Lasieranlage schneidet, bohrt und strukturiert hochpräzise ein breites Spektrum von Leiterplattenmaterialien und technischen Kunststofffolien. Dabei ist die Wärmebeeinflussung des Materials äußerst gering.

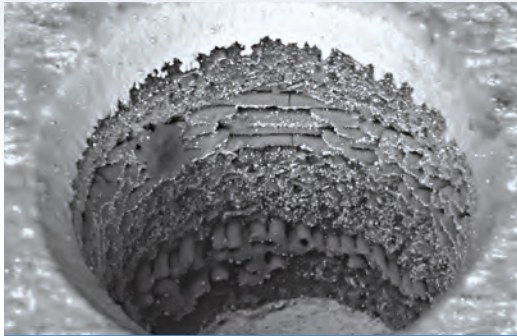


Das **Laserbohren** von **Microvias** in Leiterplatten ist eine Spezialdisziplin, die die LiMaB GmbH als anerkannten Dienstleister der Leiterplattenindustrie auszeichnet. Microvias und Sacklochbohrungen (Blind Vias) mit Durchmessern von 30 µm bis 300 µm werden in unterschiedlichem LP-Material eingebracht.

Wir bearbeiten Ihre Kleinserien innerhalb von 1-3 Arbeitstagen. Die Expressfertigung von Einzelstücken innerhalb weniger Stunden ist nach Absprache möglich, da wir unseren Leiterplattenkunden fast rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Das Leistungsspektrum im Bereich Leiterplatten- und Kunststoffbearbeitung umfasst:

- ★ verzugsfreies und schmaucharmes **Laserkonturschneiden** von **flexiblen** und **starr-flexiblen Leiterplatten** und Abdeckfolien (Coverlayer)
- ★ **Laserbohren** von Microvias, Sacklochbohrungen und Durchgangsbohrungen in Leiterplatten
- ★ **Laserstrukturieren** von Lötstopplack und Öffnen von Deckfolien (Coverlayer)
- ★ Herstellung von Isolationskanälen mit Breiten von 25 µm
- ★ Laserschneiden von dünnen Kunststofffolien, Kunststoffgeweben und Kunststoffsieben für die Medizintechnik und den Gerätebau
- ★ Laserfeinbearbeitung von kaschierten, metallisierten, bedampften oder anderen beschichteten Folien aus Kunststoff
- ★ Laserfeinschneiden von Papier und dünnen Isolationsmaterialien



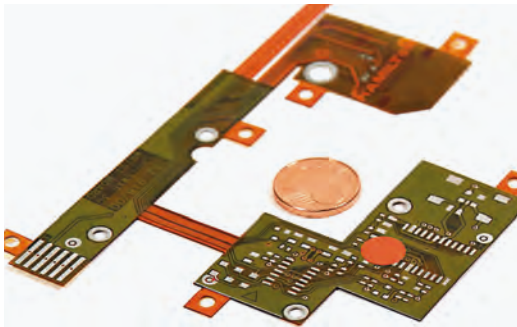
Laserbohren von Microvias
(Sacklochbohrungen) in Leiterplatten

Laser drilling of microvias in PCB materials



Präzise und saubere Schnitte
ohne Gratbildung

Burr-free and clean cuts



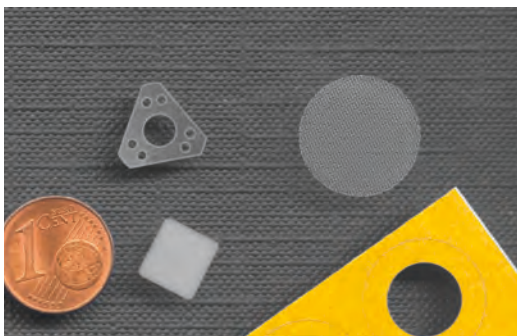
Verzugsfreies Konturschneiden von flexiblen und starr-flexiblen Leiterplatten

Stress-free cutting of flexible and rigid-flex printed circuit boards



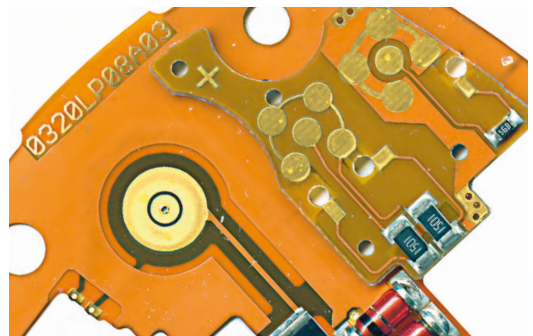
Laserkonturschneiden von Leiterplatten aus Kapton (Polyimid) und FR4

Laser cutting of printed circuit boards made of Kapton and FR4



Kunststoffsiebe, Abdeckringe aus Klebefolien, Isolierscheiben

Plastic sieves, cover rings, adhesive films, insulating washers



Vereinzeln von bestückten Leiterplatten

Depaneling of PCBs